

2 10

MSX2000M型 X線断層撮影検査装置仕様 (詳細の説明)

項目	仕様
	MSX2000M
基板サイズ	250X x 330Y mm最大
XYテーブルストローク	210X x 280Y mm
XYテーブル駆動	電動
XYテーブルサイズ	250Wx330Dmm
タッチパネル式コントロール	断層撮影/透視撮影 XYプログラム可能
X線管電圧	100KV
X線管電流	0.5mA
焦点サイズ	100micro-m
X線管球	Miniホーカス型
X線管	密閉式反射型
冷却方式	密閉式 強制空冷
傾斜角度	0度
X線漏洩線量	1 μ Sv/H以下
X線防護方式	X線防護特殊キャビネット
透視拡大率	27--37倍 (x8 GX vision)
断層イメージ拡大率	30X イメージ6.4x6.4mm (x8 GX vision)
積算回数/ラウンド	X16/1.5秒
検出器	CCD/9.6x12.8mm
CPU	Celeron 430 (1.8GHz)
メモリー	512MHB
ストレージ	CD-R/RW, FDD HD (80GB)
OS	Windows XP SP2
LCD	17型 1280x1024
画像処理機能	画質改善(アベレーシング/積算)
	エンハンス強調
	コントラスト/ブライツ調整
	4面/16面表示
画像計測 (G x Vision)	3次元表示/白黒反転/画像拡大 (1~8倍)
	X/Y 2点間距離
	楕円/円/BGA/ボイド 面積
	ワイヤー流れ/丸孔ずれ
レーザーマーカ	統計処理/キャリブレーション
	レッドマーカ
画像ボード	RICE-001/PCI バス/Rev2.1 5V 32bit 33MHz
電源	AC230V 500VA
本体サイズ	1100W x 1100D x 16000H mm
重量	約600K g

[ホーム](#) | [ご連絡](#) (戻る)